

<<电子产品生产与组装工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品生产与组装工艺>>

13位ISBN编号：9787118080261

10位ISBN编号：7118080268

出版时间：2012-4

出版时间：国防工业出版社

作者：王为民，刘岚 主编

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子产品生产与组装工艺>>

### 内容概要

《电子产品生产与组装工艺》是从电子产品制造的实际出发，按照电子产品生产工艺要求的顺序进行编写，主要包括：常用电子元件的识别与检测、常用电子材料的识别、电子元器件的焊接及工艺、电子产品的组装及工艺、电子产品的调试、电子产品的检验与包装。全书共6章，每章均有思考与练习。

读者通过学习本书内容，既能够掌握生产操作中的基本技能，又能从工艺工程师、管理人员的角度认识电子产品的生产全过程。本书可作为中、高等职业学校的电子信息、电子应用或smt类专业课程的教材，也可作为电子爱好者和一些制造业现场管理、操作人员等的教材与自学参考书。

## 书籍目录

## 第1章 常用电子元器件的识别与检测

- 1.1 电阻器的识别与检测
  - 1.1.1 电阻器的分类
  - 1.1.2 电阻器和电位器的型号命名方法
  - 1.1.3 电阻器的主要技术指标
  - 1.1.4 电阻器的识别方法
  - 1.1.5 电阻器的检测
- 1.2 电容器的识别与检测
  - 1.2.1 电容器的分类
  - 1.2.2 电容器的型号命名方法
  - 1.2.3 电容器的主要技术指标
  - 1.2.4 电容器的识别方法
  - 1.2.5 电容器的检测
- 1.3 半导体分立元器件的识别与检测
  - 1.3.1 半导体器件的分类
  - 1.3.2 半导体器件的型号命名法
  - 1.3.3 半导体器件的主要技术指标
  - 1.3.4 半导体器件的检测
- 1.4 集成电路的识别与检测
  - 1.4.1 集成电路的分类
  - 1.4.2 集成电路的型号命名方法
  - 1.4.3 集成电路的识别
  - 1.4.4 集成电路的检测
- 1.5 电感器和变压器的识别与检测
  - 1.5.1 电感器和变压器的分类
  - 1.5.2 电感器和变压器的主要技术指标
  - 1.5.3 电感器和变压器的检测
- 1.6 压电元件和霍耳元件的识别与检测
  - 1.6.1 压电元件和霍耳元件的分类
  - 1.6.2 压电元件和霍耳元件的主要技术指标
  - 1.6.3 压电元件和霍耳元件的检测
- 1.7 表面安装元器件的识别与检测
  - 1.7.1 表面安装元器件的分类
  - 1.7.2 表面安装元器件的包装种类
  - 1.7.3 表面安装元器件的使用要求与选择

## 思考与练习

## 第2章 常用电子材料的识别

- 2.1 导线
  - 2.1.1 导线的分类
  - 2.1.2 导线的命名方法
  - 2.1.3 导线的选用
- 2.2 绝缘材料
  - 2.2.1 绝缘材料的分类
  - 2.2.2 绝缘材料的性能指标
  - 2.2.3 绝缘材料的用途

## <<电子产品生产与组装工艺>>

### 2.3 磁性材料

#### 2.3.1 磁性材料分类

#### 2.3.2 常用磁性材料的主要用途

### 2.4 印制电路板

#### 2.4.1 覆铜箔板的种类与选用

#### 2.4.2 印制电路板的特点及分类

### 2.5 黏合剂

#### 2.5.1 常用黏合剂的类型

#### 2.5.2 常用黏合剂的特点与应用

### 2.6 焊接材料

#### 2.6.1 焊料

#### 2.6.2 助焊剂

#### 2.6.3 阻焊剂

#### 思考与练习

## 第3章 电子元件的焊接工艺

### 3.1 手工锡焊

#### 3.1.1 手工锡焊工具

#### 3.1.2 手工锡焊的方法与技巧

#### 3.1.3 手工锡焊的质量判定

### 3.2 手工拆焊

#### 3.2.1 手工拆焊的工具

#### 3.2.2 手工拆焊的操作技巧

### 3.3 自动锡焊

#### 3.3.1 自动锡焊设备

#### 3.3.2 自动锡焊工艺

#### 3.3.3 贴片元件的手工操作

#### 思考与练习

## 第4章 电子产品的组装及工艺

### 4.1 电子产品的组装概述

#### 4.1.1 电子产品的组装内容与工序

#### 4.1.2 电子产品的整机组装

#### 4.1.3 电子产品的整机组装专用设备介绍

#### 4.1.4 电子产品整机组装中的静电防护

### 4.2 元器件的组装工艺

#### 4.2.1 常用元器件的组装要求和方法

#### 4.2.2 压接、绕接和螺纹连接

### 4.3 表面贴片元件的组装及工艺

#### 4.3.1 表面贴片元件组装用到的材料

#### 4.3.2 表面贴片元件设备

#### 思考与练习

## 第5章 电子产品组装后的调试

### 5.1 概述

#### 5.1.1 常用调试设备配置

#### 5.1.2 调试的内容和程序

#### 5.1.3 调试的一般流程

### 5.2 调试的一般工艺

#### 5.2.1 调试工艺的要求

## <<电子产品生产与组装工艺>>

5.2.2 调试前的准备

5.2.3 单元部件调试的一般工艺流程

5.2.4 整机调试的一般工艺流程

5.2.5 整机的调试类型

5.2.6 调试的安全措施

5.2.7 整机电路调试实例

思考与练习

### 第6章 电子产品的检验和包装

6.1 电子产品的检验

6.1.1 电子产品检验的目的和方法

6.1.2 电子产品的检验内容

6.2 电子产品的包装

6.2.1 电子产品的包装类型及要求

6.2.2 电子产品的包装材料

6.2.3 电子产品包装的标志

思考与练习

附录思考与练习参考答案

参考文献

<<电子产品生产与组装工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>